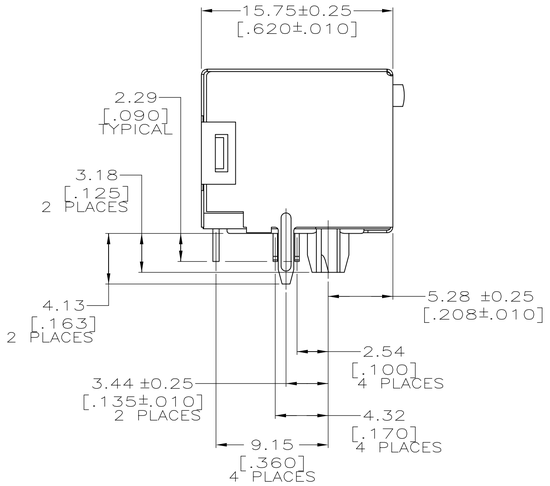
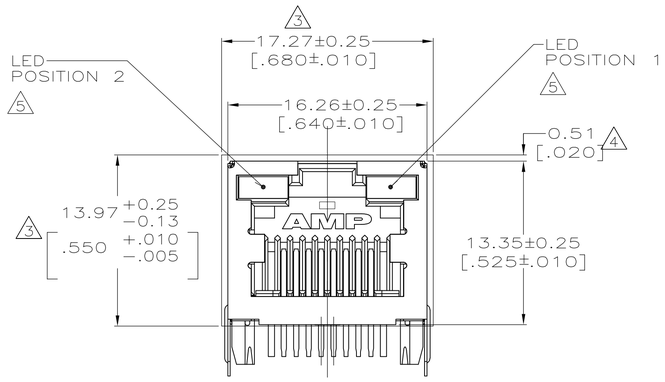
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ,- .
© COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

| LOC | DIST |
|---|---|
| AA | 22 |

REVISIONS

| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | REVISED PER ECO-11-005033 | 28MAR11 | RK | HMR |




1. MATERIAL:
HOUSING – HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK, UL94V-0.
TERMINALS – 0.36 THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 3.81 µm MIN THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA. 1.27 µm [.000050] MINIMUM GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA. ENTIRE TERMINAL PLATED WITH 1.27 µm MIN THICK NICKEL.
SHIELD – 0.196 THICK COPPER ZINC ALLOY PREPLATED WITH 1.27 µm MIN SATIN NICKEL WITH 2.03 µm MIN TIN POST DIPPED ON PCB GROUND TABS.
LIGHT EMITTING DIODE (LED) – DIFFUSED EPOXY LENS, 0.51 x 0.51 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PREPLATED WITH 8.89 µm THICK Sn/Cu OVER 2.03 µm THICK Ag OVER 1.02 µm THICK Cu OVER 3.56 µm THICK Ni OVER 1.02 µm THICK Cu UNDERPLATE

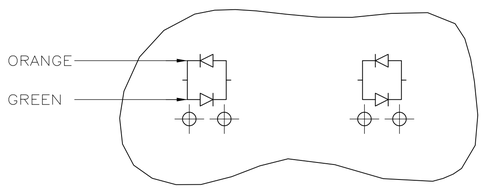
2. JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIIONS PART 68, SUBPART F.

3. SUGGESTED PANEL OPENING DIMENSIONS.

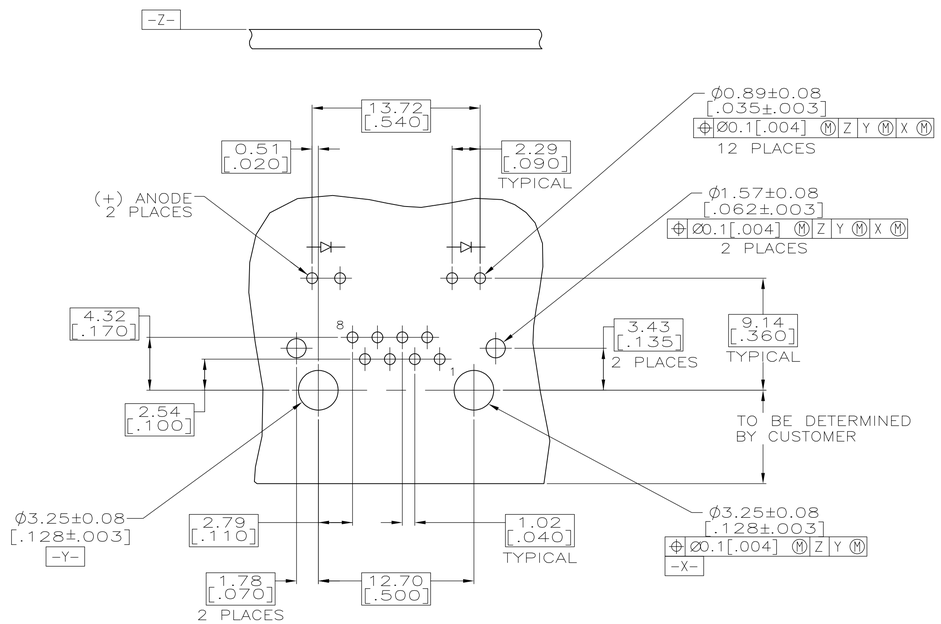
4. SUGGESTED CLEARANCE BETWEEN TOP OF CONNECTOR AND TOP PANEL OPENING.

5. SEE TABLE FOR COLOR OF LEDS AND NUMBER REQUIRED.

6. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.




LED CURRENT DIAGRAM
1116075-7 ONLY




SUGGESTED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

| ORANGE/GREEN | ORANGE/GREEN | 6116075-7 |
|---|---|---|
| YELLOW | YELLOW | 6116075-6 |
| GREEN | GREEN | 6116075-5 |
| GREEN | YELLOW | 6116075-4 |
| YELLOW | – | ~~6116075-3~~ |
| – | GREEN | ~~6116075-2~~ |
| YELLOW | GREEN | 6116075-1 |
| POSITION 2 | POSITION 1 | PART NUMBER |
| INDICATOR COLOR | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± 0.25[.01]
3 PLC ± 0.13[.005]
4 PLC ± –
ANGLES ± –

MATERIAL: SEE NOTE 1
FINISH: SEE NOTE 1

DWN 30APR2005 T. SPRINKLE/L.A.MAYER
CHK 30APR2005 J.WESTMAN
APVD 30APR2005 S.FLICKINGER
PRODUCT SPEC 114-2154
APPLICATION SPEC 108-1163-4
WEIGHT –

TE Connectivity

NAME: INVERTED MODULAR JACK ASSEMBLY, 1X1, SHIELDED, LED

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-6116075 | RESTRICTED TO –

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV A1

4805 (3/11)

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

*Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.*

*С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров*

*Мы предлагаем:*

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

*В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.*

*Конструкторский отдел помогает осуществить:*

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

*Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)*
*Email: org@lifeelectronics.ru*

***www.lifeelectronics.ru***